

**性能特点：**

- 频率范围：6GHz-12GHz
- 转换增益：-13.5dB
- F0 隔离度：35dBc
- 3F0 隔离度：35dBc
- 4F0 隔离度：28dBc
- 输入信号功率：15dBm
- 芯片尺寸：1.4mm×0.69mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-MP205 是一种 GaAs MMIC 无源倍频器，此款倍频器芯片在输入功率为 15dBm 时，转换增益典型值为-14dB，对基波抑制制度达到 35dBc，对三次谐波抑制制度达到 35dBc，对四次谐波抑制制度达到 30dBc,典型输入功率为 15dBm。

**电参数：** (TA=25°C, Pin=15dBm)

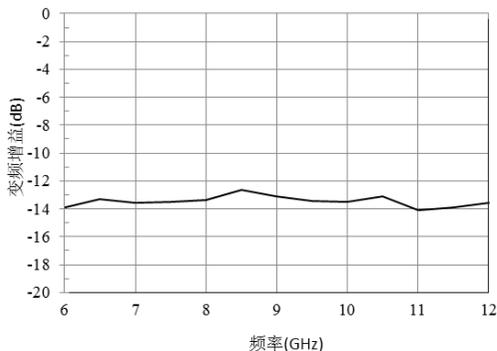
指标	最小值	典型值	最大值	单位
输入频率	6-12			GHz
输出频率	12-24			GHz
转换增益	-13	-13.5	-14	dB
基波抑制制度	35	-	-	dBc
三次谐波抑制制度	35	-	-	dBc
四次谐波抑制制度	28	-	-	dBc

**使用限制参数：** (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

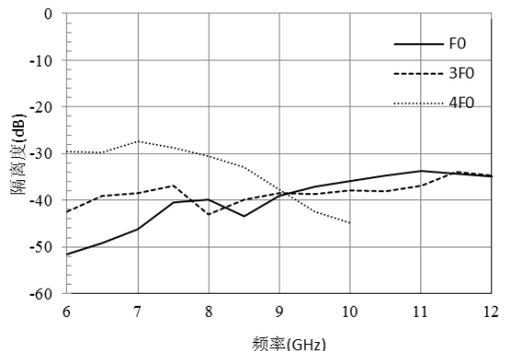
最大输入功率	27 dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-125°C

**典型曲线：**

转换增益曲线@Pin=15dBm



隔离度@Pin=15dBm



尺寸图：(单位 mm)



06

建议装配图：



使用说明：

**注意事项：**输入输出有隔直电容

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。